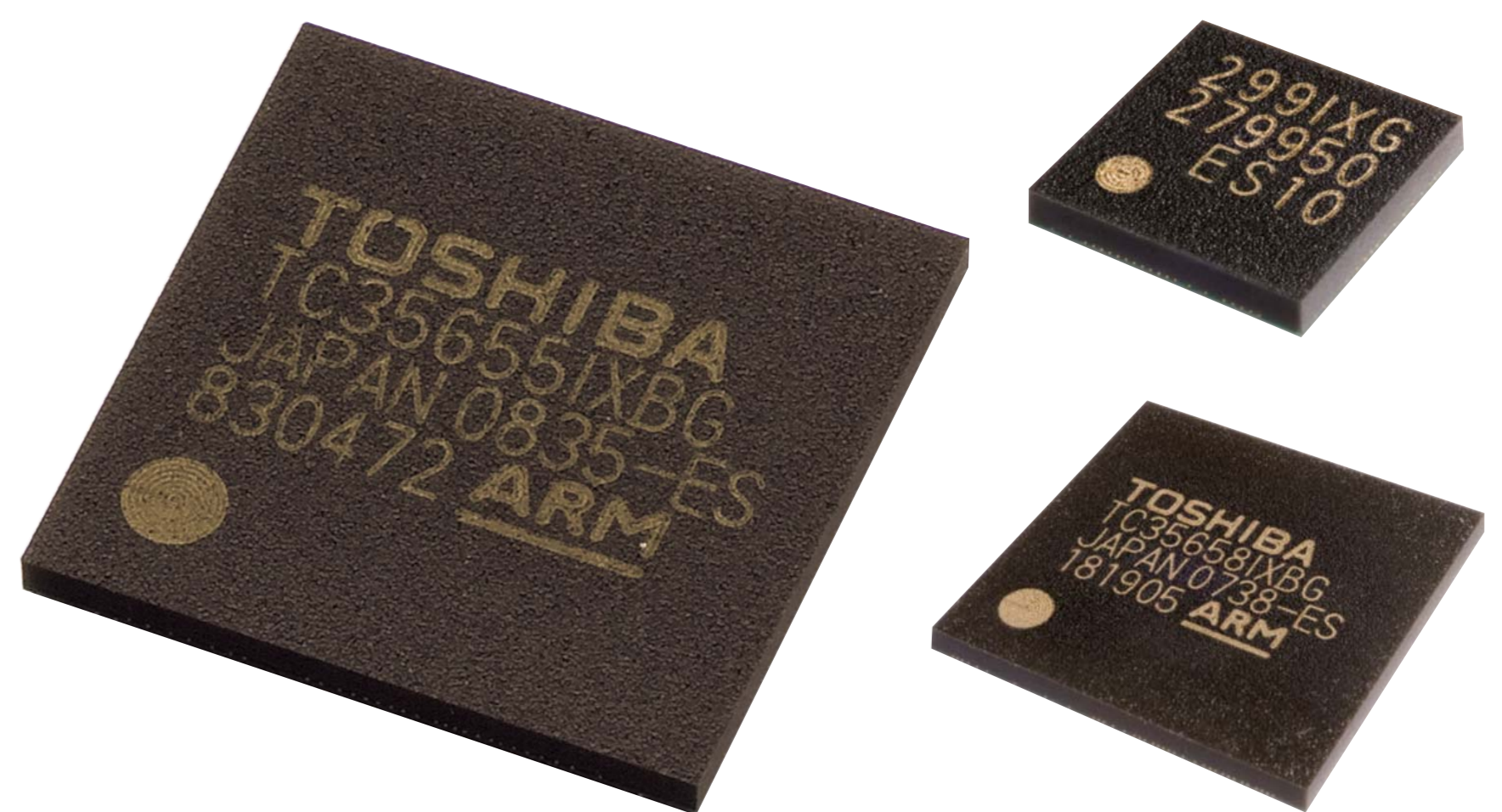


# 車載向け高性能 Bluetooth<sup>®</sup>チップセット

## POINT

Bluetooth<sup>®</sup>通信と高度な音声処理を同時に行い、快適なハンズフリー環境を提供

- 優れたBluetooth<sup>®</sup>接続品質
- CMOSプロセスによりRFとデジタル部をシステム集積し、コスト力強化
- EDR規格準拠、マイナス90dBmの世界トップレベルの受信感度



用途	廉価版ソリューション	高性能ソリューション	
品番	TC356551XBG	TC356581XBG	TC312991XBG
品種	1chip(Baseband+RF) LSI	Baseband LSI	RF IC
対応Spec.	Ver.2.1+EDR		
Status	サンプル出荷中 量産 09/4Q	量産中	
パッケージ	11mm x 11mm x 1.2mm 225 ボール BGA	12mm x 12mm x 1.4mm 289 ボール BGA	5mm x 5mm x 1.4mm 52 ボール BGA
動作温度範囲	-40°C ~ +85°C		

### 製品の技術的特長

#### 1Chip (BaseBand+RF) LSI TC356551XBG

- 音楽処理用コアとしてのARM9 CPUを1個搭載したBaseBand LSIとRF ICをRFCMOS技術でワンチップ化
- 当社従来製品と比較して、実装面積を28%削減し、低消費電力化を実現

#### BaseBand LSI TC356581XBG

- 音声処理用コアとして最高動作周波数208MHzのARM9 CPUを2個搭載し、従来比約2倍の高性能な音声能力を実現
- 通信コアと音声処理コアを独立して内蔵、Bluetooth<sup>®</sup>通信と音声機能を高効率で連動処理

#### RF IC TC312991XBG

- EDR規格に準拠し、マイナス90dBmという世界トップレベルの受信感度をRFCMOSで実現

